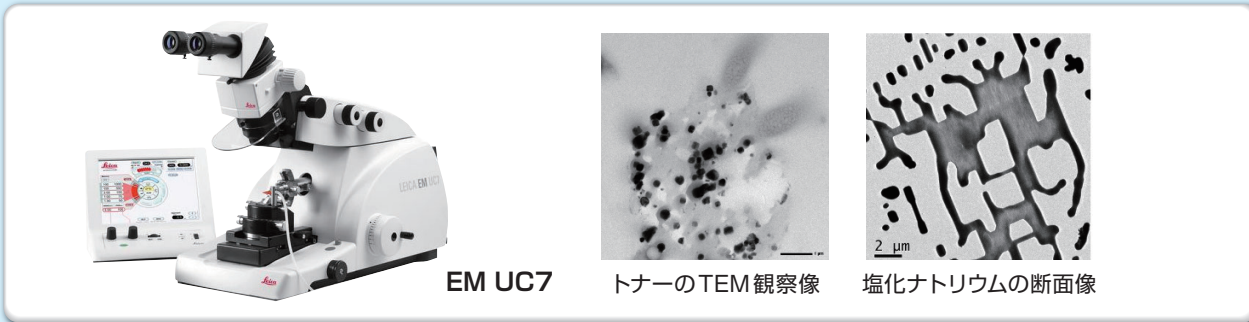


EM UC7 Leicaウルトラマイクローム

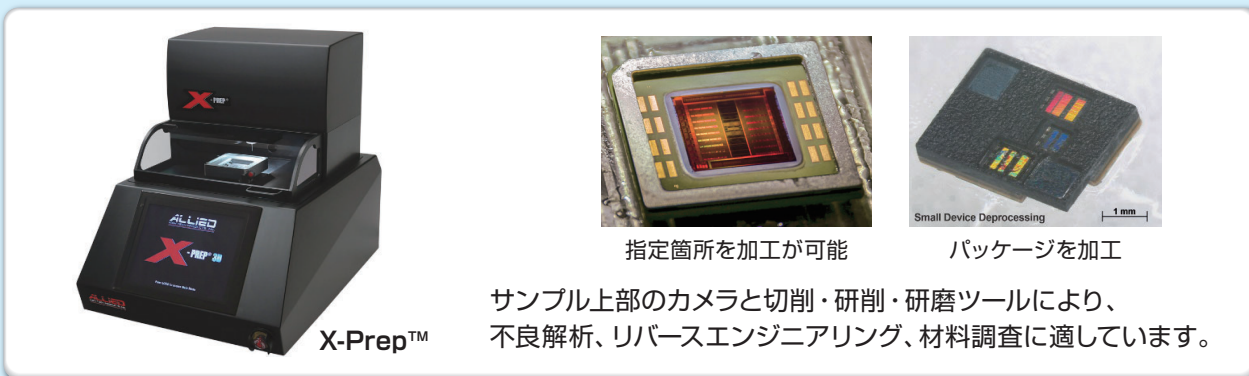
工程D



特長・仕様

- 100nm以下の超薄切片を作製することができます。
- 対象サンプル：高分子材料、無機材料、複合材料、柔らかい金属
- 水を使わず観察面を作製することができます。
- 寸法/重量：350(W)×530(D)×540(H)mm/40kg (コントローラ部は除く)
- (ドライナイフ切削の場合)

X-Prep™ ALLIED精密ミリング/ポリッシングシステム



特長・仕様

- ツールの回転数：5,000～100,000rpm
- 最大加工領域：100×100mm
- 研磨対象サンプル：セラミック・シリコン・金属・ガラス
- 寸法/重量：533(W)×686(D)×622(H)mm/95kg

【備考】：輸入製品のため仕入れ価格の変動・見直しにより、予告なく価格改定となる場合があります。詳細価格のお問い合わせに関しては、弊社各拠点より個別に見積もり対応させていただきます。

詳細は弊社サービスエンジニアまでお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社 日立ハイテックフィールドディング
電子顕微鏡部
〒105-6410
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
<https://www.hitachi-hightech.com/hfd/>

お客様サポートセンター

フリーコール **0120-203-813**

S.I.navi 日立ハイテック会員制サイト(エスアイナビ)
<https://biz.hitachi-hightech.com/sinavi/>

●本カタログに掲載の内容は、予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載している写真や図は、標準仕様の場合です。装置の仕様や構成によって異なります。

本カタログは2020年1月現在のものです。

DS1711010Rev.01

**電子顕微鏡用
前処理機器のご案内**

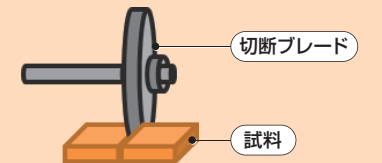
サンプルの表面形態および内部構造の観察・解析には、適切な機器を用いた前処理を行うことが重要です。電子顕微鏡用のサンプル作製に適切な機器をご提案します。



サンプル加工フロー

工程A

加工・観察機器に合わせたサンプルの切り出し

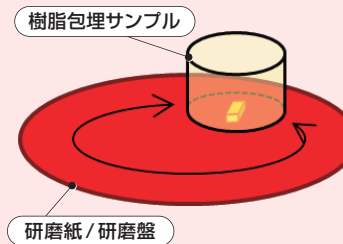


内部構造解析のための
断面作製の場合

透過像を得るための
薄片化の場合

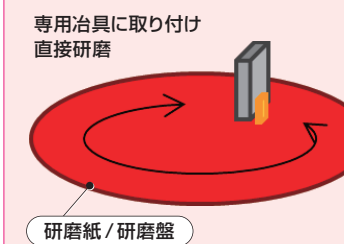
工程B

樹脂埋めしたサンプル
機械研磨



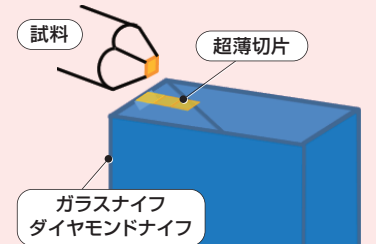
工程C

樹脂埋めしないサンプル
機械研磨



工程D

マイクロームにて
超薄切片作製



SEM/TEMおよび分析機器を用いた観察・解析

お客様に安心してご使用いただけるよう、納入後のオペレーションサポート、メンテナンスにつきましてもメニューをご用意しております。

TechCut5™ ALLIED精密高速切断機

工程A



TechCut5™



大型サンプルの固定・切断が可能



切り出しの位置調整

切断条件(サンプルの送り速度および力)を制御することで、サンプルに応じた最適な条件で切断することができます。

特長・仕様

- さまざまな形状のサンプルを固定できる多様なアクセサリがあります。
- サンプルの切り出し位置をミクロン単位で微調整できます。(オプション)
- ブレードサイズ: 76 ~ 200mm
- 最大試料サイズ: 152(W)×152(D)×64(H)mm
- 寸法/重量: 620(W)×545(D)×476(H)mm/67kg

MetPrep3™/AD-5™ ALLIED包埋試料研磨装置

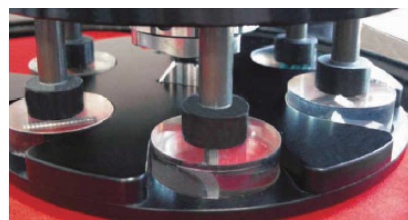
工程B



AD-5™ MetPrep3™/PowerHead



MetPrep3™プログラム設定画面



包埋サンプルの個別加重研磨

複数の試料研磨に適した半自動式の包埋試料研磨装置です。アタッチメントを交換することで、1個から最大6個までの試料を研磨できます。

特長・仕様

〈MetPrep™/PowerHead〉

- 25通りの研磨条件を登録することができます。
- 試料に対して2種類の荷重方式を選択可能であり、荷重の調節も可能です。セントラルプレッシャー(全体荷重): 22 ~ 219N(4N刻み) インディビジュアルプレッシャー(個別荷重): 0 ~ 70N(4N刻み)
- サンプル個別加重・全体加重で研磨ができます
- 研磨盤/サンプル回転数: 40 ~ 600rpm/0 ~ 150rpm(10rpm刻み)
- 寸法/重量: 380(W)×683(D)×569(H)mm

〈AD-5™〉液体ディスペンサー

- 5種類の研磨剤液をセットできます。
- 25通りの条件を登録できます。

M-Prep5™/M-Prep6™ ALLIED手動研磨装置

工程B



M-Prep5™

特長・仕様

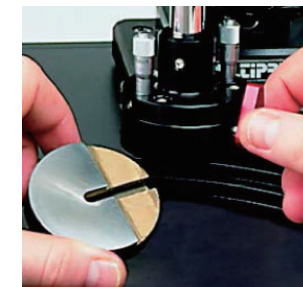
- 給水機構を付属した手動研磨装置です。
- 研磨盤の回転数: 10 ~ 500rpm(10rpm刻み)
- 寸法/重量:
M-Prep5™
381(W)×660(D)×229(H)mm/30kg
M-Prep6™
560(W)×690(D)×267(H)mm/45kg

MultiPrep™システム ALLIED精密研磨装置

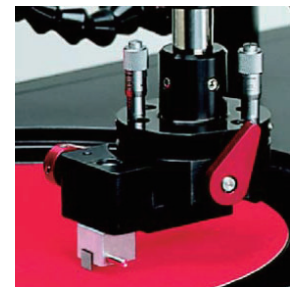
工程C



MultiPrep™システム

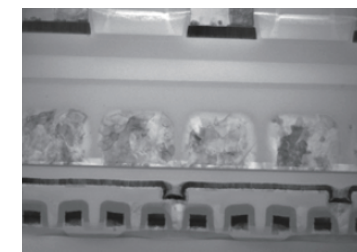


カムロックシステム

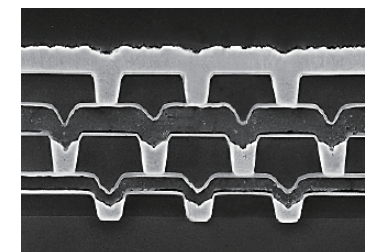


非包埋サンプルの断面研磨

デュアルマイクロメーター



TEM観察 IC-断面



FE SEM観察 IC-断面

樹脂埋めしていない試料の断面研磨や平行研磨、半導体試料(ウェーハ*)の裏面研磨など多様な研磨用途に1台で対応可能な汎用性の高い半自動試料研磨装置です。

※12インチ(300mm)タイプもあります。

特長・仕様

- サンプルの回転(ローテーション)・反転(オシレーション)研磨ができます。
- 多彩な試料固定アクセサリがあります。
- カムロックシステムによりサンプルの固定・着脱が手軽にできます。
- デジタルインジケータにより1μm単位で研磨量を確認できます。
- サンプル傾斜調整角度: +10°/-2.5°(0.02°刻み)
- 研磨盤回転数: 10 ~ 350rpm(5rpm刻み)
- 寸法/重量: 381(W)×680(D)×508(H)mm/43kg